

晶背减薄机UltraPrep

产品名称	晶背减薄机UltraPrep
公司名称	深圳市泰斯特尔系统科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗南路东久创新科技园3栋5楼
联系电话	0755-23303946

产品详情

晶背减薄机

UltraPrep设计专门且特殊的功能，用于封装芯片的减薄及抛光制备。通过UltraPrepIII减薄和抛光的芯片，因为可以达成接近均匀的芯片厚度所以适合于需要由晶背检测的应用，它的特性还可以应用在散热片和散热器的去除，以及塑料和芯片间隔材料。用来达成将封装样品中的芯片裸露出来它为整个晶背的样品制备提供了一个易于使用的解决方案。

UltraPrepIII是一个小型，特殊设计的类似CNC加工系统，用户籍由图形接口控制，操作员选择所需的动能并输入样品的尺寸信息进行操作，在加上视频对位装置，使的操作上快速和容易。他不需要样品调平装置，因为UltraPrep可以将精确地剖析样品表面，再根据存储的表面轮廓移动工具。这让不平坦或翘曲的样品在制作完成后厚度仍保持均匀。

晶背减薄机UltraPrep产品特点

- 快速简易的设置，并包含视觉对位能力
- 四角标定功能容许待工作样品有旋转角度的误差
- 简单的操作接口可达成复杂的编成程序
- 自动，系统化减薄及抛光程序
- 程控工作深度，精度达到 ± 1 微米
- 可移除样品治具，可以允许整个取下观察，清洁，而不须将样品分离或重新固定在治具上
- 抛光研磨时，工具依照剖析后的曲面移动
- 在样品装置上不需要调平
- 芯片减薄后zui终厚度变异量小于 ± 0.005 mm
- 手动输入样品厚度以进行精确的厚度控制

简易的移除散热片，封装材料及芯片固定胶层
容易取得廉价的工具使用
设备体积小- 占用较小的工作空间
样品制备时，接近零的垂直应力

晶背减薄机UltraPrep规格参数

尺寸：375 * 375 * 350 mm (W*H*D)

重量：30 Kg

电源：90 - 250 V/ 49 - 61 Hz / 4 A

X轴行程：100 mm (75 mm usable)

Y轴行程：75 mm

Z轴行程：65 mm

zui大速度：450 mm/minute

zui大转速：10,000 RPM

X/Y轴向精度：0.000488 mm

Z轴向精度：0.000397 mm

位置误差：± 0.00025 mm / 1 mm

Z轴重复精度：± 0.0015 mm

X/Y轴重复精度：± 0.002 mm

可加工DIE尺寸：2 mm - 36.0 mm

zui大封装尺寸：67.5 mm X 52.8 mm

显示屏：7 inch diagonal